

钎焊湿润性优越的光亮镍电镀工艺去

SOLDATIVE PROCESS

SOLDATIVE PROCESS 是指在原来的光亮镍浴中添加 SOLDATIVE 系列产品，从而获得具有钎焊湿润性的光亮镍镀层工艺。它用于镀金，镀银时的镀镍底材，能使镀金，镀银的镀膜变薄。

另根据与后处理剂SOLDA系列的组合，也可以使钎焊湿润性优势有所提高。

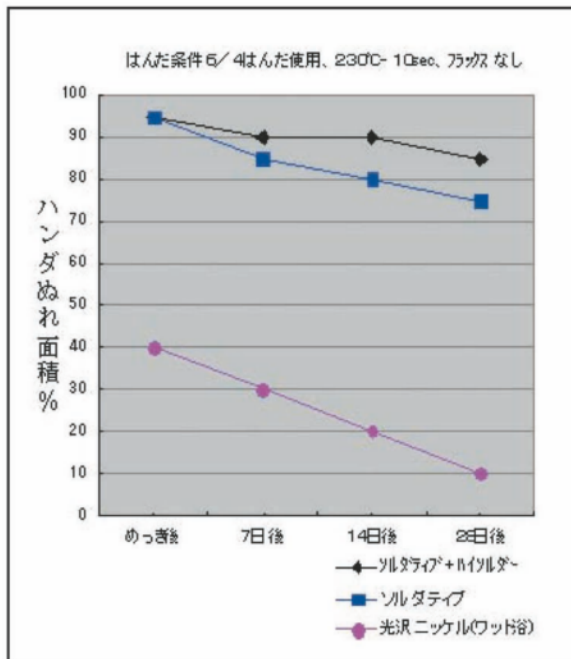
【特点】

- ◇ 具良好的钎焊性
- ◇ 能得到高纯度的镍镀膜
- ◇ 光亮剂里不含硫磺(S)
- ◇ 具良好的延展性及硬度

【物理的特性】

- ◇ 电镀硬度 500 ~ 580 HV
- ◇ 外观 金属光亮
- ◇ 磁性 有磁性

【钎焊湿润性的变化】



【SOLDATIVE 接触电阻值】

| | 1.0 A / dm ² | 2.5 A / dm ² |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| SOLDATIVE | 3.8 ~ 5.0 mΩ | 7.11 ~ 11.0 mΩ |
| 光亮镍 (瓦特浴) | 0.13 ~ 0.18 Ω | 10 Ω 以上 |
| 无光亮镍 | 2.0 ~ 2.8 mΩ | 2.6 ~ 3.1 mΩ |

【镀金钎焊的接触电阻值】

| | 镀金涂膜的厚度 | 接触电阻 (mΩ) |
|-----------|---------|-----------|
| SOLDATIVE | 0.5 | 2.1 ~ 3.0 |
| | 1.0 | 1.8 ~ 2.8 |
| 光亮镍 (瓦特浴) | 0.5 | 3.2 ~ 4.2 |
| | 1.0 | 3.1 ~ 4.2 |



株式会社 清水

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18
 TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801
 Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主 (上海) 贸易有限公司
 上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 号楼 5 层 E 座
 Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339
 Website: <http://www.shimizu.com.cn>
 E-mail: shimizu@shimizu.com.cn